

修改单

T/TMAC 416—2026《高密度互连(HDI)PCB 设计规则与布线规范》第1号修改单。

本修改单经中国技术市场协会批准，建议自2026年10月15日起实施。

T/TMAC 416—2026《高密度互连(HDI)PCB 设计规则与布线规范》修改内容如下：

前言部分信息登记有误，特此更正：

将原标准：

本文件起草单位：胜宏科技(惠州)股份有限公司、深圳华秋电子有限公司、北京中研博采技术服务有限公司、北京六只猫创意科技有限公司、北京彬诚科技有限公司。

本文件起草人：陈涛、陈遂佰、王辉、李晓锋、乐志斌、夏卫彬、杨笛。

修改为：

本文件起草单位：胜宏科技(惠州)股份有限公司、深圳华秋智联股份有限公司、惠州市特创电子科技股份有限公司、生益电子股份有限公司、北京中研博采技术服务有限公司、北京六只猫创意科技有限公司、北京彬诚科技有限公司。

本文件起草人：陈涛、陈遂佰、王辉、李晓锋、陈金星、任尧儒、乐志斌、夏卫彬、杨笛。

中国技术市场协会标准化工作委员会

2026年9月3日